

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
идеологической работе и
общим вопросам

 Я. О. Матиевич

« 19 » 05 2026 г.

Техническое задание на закупку
персональных компьютеров в количестве 25 шт.

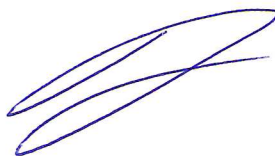
Основные технические требования:

№ п/п	Наименование	Технические требования	Ко- во шт.
1	Процессор	AMD Ryzen 9 9950X или аналог не хуже по тестам Cinebench R23	1
2	Материнская плата	Форм фактор ATX. Чипсет не хуже типа X или аналог Слоты памяти-не менее 4 с поддержкой до 192 Гб. Поддержка DDR5 Не менее 22 фаз питания. Не менее одного порта HDMI, не менее 2 портов USB Type-C (USB 4.0) с поддержкой вывода на дисплеи, Поддержка 4K@60Hz HDMI 2.1, не менее 2 слотов с поддержкой PCIe 5.0 x16 с Q-Release Slim, не менее 3 слотов M.2 с поддержкой PCIe 5.0 x4 одновременно, не менее 4 портов SATA 6 Гбит/с. Не менее 2 Ethernet Lan портов со скоростью не менее 2.5 Гбит/с. Wi-Fi, Bluetooth. Не менее 8 задних USB 10 Гбит/с. из них 6 Type-A и 2 Type-C. Наличие документации, драйверов, спецификации на модули памяти и поддерживаемых процессоров на сайте производителя на русском или английском языке.	1
3	Оперативная память	Планки одинаковой модели и партии (Kit) по 16 Гб каждая в сумме 32 Гб., DDR5 от PC5-51200 частота не менее 6600 МГц и таймингами не более CL 32T. Напряжение не более 1.4 В. Наличие документации на сайте производителя на русском или английском языке. Память обязательно должна быть прописана на сайте материнской платы в разделе совместимости.	1
4	Корпус	Тип корпуса: Mid Tower или Mini Tower Корпус должен быть с сетчатыми панелями по периметру. Конструкция корпуса должна обеспечивать возможность визуального контроля состояния внутренних компонентов без разборки корпуса при обслуживании оборудования Минимум 3 вентилятора PWM, 2 (160мм) из которых на вдув, а 1 на выдув (140мм), и контролер управления вентиляторов. Поддержка водяного охлаждения с радиатором 360мм. Не менее 4 установочных мест для накопителей типа SATA 2.5 и 3.5. Модульная конструкция корпуса. Наличие не менее 2 USB 3.0 и не менее 1 USB Type C на передней стенке корпуса (сверху).	1

		Возможность установки больших видеокарт не менее 390мм. Корпус не должен превышать по высоте 495 ±5 мм. Наличие пылевого фильтра спереди и сзади Наличие документации на сайте производителя на русском или английском языке.	
5	Кулер	Отвод тепловой мощности должен соответствовать реальному тепловыделению процессора. Жидкостное охлаждение с радиатором. ЖК экран для отображения (температуры ЦП, и частоты) с фирменным софтом. Акустический шум при типовой нагрузке — от 25 до 32 дБ(А);. Гидродинамический подшипник (или не хуже) Управление скоростью вращения со стороны материнской платы Наличие документации на сайте производителя на русском или английском языке.	1
6	Блок питания	Мощность не менее 1000W КПД не менее 90% Сертификация 80 plus Platinum Сертификат Cybenetics платина Вентилятор не менее 120 мм с ШИМ и гидродинамическим подшипником Стандарт блока ATX12V 3.1 Полностью модульные кабели, кабели в оплетке Кабель питания PCIe Gen5 (12V-2x6) и CPU 1x8 pin+1x4+4 pin Активная PFC Наличие документации на сайте производителя на русском или английском языке.	1
7	SSD диск	Форм фактор M.2 (2280) Интерфейс PCIe Gen 5 x 4, NVMe 2.0 Поддержка TRIM, S.M.A.R.T., GC., шифрования AES 256-битное, режим сна. Чипы V-NAND TLC Последовательное чтение не менее 14700 Мб/с. Последовательная запись не менее 13300 Мб/с. Случайное чтение (4 Кб, QD32) Не менее 1 850 000 IOPS Случайная запись (4 Кб, QD32) Не менее 2 600 000 IOPS Не менее 1.5 млн часов время наработки на отказ. Объем не менее 1000 Гб. Наличие документации на сайте производителя на русском или английском языке.	1
8	SSD диск	Форм фактор M.2 (2280) Интерфейс PCIe Gen 4 x 4. Чипы 3D TLC NAND или MLC. Последовательное чтение не менее 7300 Мб/с. Последовательная запись не менее 7000 Мб/с. Случайное чтение (4 Кб, QD32) Не менее 1 000 000 IOPS Случайная запись (4 Кб, QD32) Не менее 1 000 000 IOPS Не менее 2 млн часов время наработки на отказ. Объем не менее 2000 Гб. Наличие документации на сайте производителя на русском или английском языке.	1

9	Видеокарта	Частота ядра не менее 2790 МГц, Наличие не менее 84 RT ядер Объем ОЗУ не менее 16 Гб Тип Озу GDDR7 Шина не менее 256 бит Частота памяти не менее 30 Гб/с Поддержка PCI-E 5.0 Максимальное разрешение не менее 7680x4320 Поддержка DirectX 12 Ultimate Поддержка OpenGL 4.6 Выходы Displayport x 3 (2.1b), HDMI (2.1b) x 1 с поддержкой режимов 4K/480 Гц HDR и 8K/120 Гц с DSC. 3-х кулерная система охлаждения (не менее) с хорошим толстым радиатором (толщина, занимаемая видеокартой не менее 3 и не более 4 слотов) Поддержка подключения 4 мониторов. Наличие документации, драйверов на сайте производителя на русском или английском языке.	1
10	Кабель	HDMI-DP 1.4 3м (DP101 10203)	1
11	Кабель	DP-DP 3м (DP112 60844)	1
12	Комплектность поставки	Комплект поставки каждого компьютера должен полностью соответствовать заводской упаковке (комплектации) производителя системного блока, монитора и комплектующих. Поставщик обязан передать Покупателю всю сопутствующую документацию, аксессуары и расходные материалы, входящие в комплект поставки компонентов (системного блока, блока питания, материнской платы, процессора, корпуса, видеоадаптера, накопителей), включая, но не ограничиваясь: Кабели интерфейсные (SATA, IDE и пр.), не задействованные в сборке. Переходники питания (например, Molex-SATA). Комплектные кабели Блока питания (все неиспользованные разъемы должны быть аккуратно уложены в корпусе или отдельном пакете). Комплектные стяжки (кабельные хомуты) для укладки проводов внутри корпуса. Комплектные крепежные элементы (винты, стойки для материнской платы, заглушки для слотов расширения). Краткие руководства пользователя. Накопители с драйверами и программным обеспечением (если они предусмотрены заводской комплектацией, даже если драйверы уже установлены). Дополнительные планки крепления для 2.5" накопителей в корпусе и прочие аксессуары, поставляемые с корпусом. Запасные колпачки для разъемов.	

Начальник ОВД



Д.А. Бончковский